

| 期刊  | 封面故事          | 趋势与分析 |       |      |      | 设计与技术   |               |              |                     |
|---|---------------|-------|-------|------|------|---|---------------|--------------|---------------------|
|   |               | 业界趋势  | 思维与观点 | 精英访谈 | 模拟设计 | 设计新技术   | 测试与测量         | New Products | Hardware Innovation |
| <b>1月刊</b><br>广告预订截止日期: 2024年11月22日<br>材料提交截止日期: 2024年11月28日  | 新年展望          | •     | •     | •    | •    | - 5G/6G/RF/ 无线通信<br>- AIoT/ 嵌入式设计<br>- AI/HPC/ 云计算 / 边缘计算       | 频谱分析仪         | •            |                     |
| <b>2月刊</b><br>广告预订截止日期: 2024年12月23日<br>材料提交截止日期: 2024年12月30日  | EDA/IP        | •     | •     | •    | •    | - PCB 设计 /FPGA/DSP<br>- 高频设计 /RF/ 微波<br>- 嵌入式设计                 | 微波射频测试        | •            | •                   |
| <b>3月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年1月20日<br>材料提交截止日期: 2025年1月22日    | 先进工艺 / 先进封装   | •     | •     | •    | •    | - RISC-V/Chiplet/3D 堆栈<br>- 硅光子 / 量子计算<br>- 异构集成 / 混合键合         | 示波器           | •            | •                   |
| <b>4月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年2月20日<br>材料提交截止日期: 2025年2月28日    | AI 大芯片        | •     | •     | •    | •    | - AI/ML/LLM/LQM<br>- 生成式 AI/AI Agent<br>- 人机交互 / 视频监控           | 混合信号测量        | •            |                     |
| <b>5月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年3月20日<br>材料提交截止日期: 2025年3月28日    | 电源管理          | •     | •     | •    | •    | - LED 照明 /ADC/DAC/ 智能电网<br>- 新能源<br>- 数据中心 / 云计算                | 仿真软件<br>测试与认证 | •            | •                   |
| <b>6月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年4月21日<br>材料提交截止日期: 2025年4月28日    | 边缘智能          | •     | •     | •    | •    | - TinyML/MCU<br>- 智能家居 / 智慧城市<br>- OT/ 半导体信息安全 / 加密             | EMI           | •            |                     |
| <b>7月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年5月20日<br>材料提交截止日期: 2025年5月28日    | 智能车联网 / 舱驾一体化 | •     | •     | •    | •    | - 电池 /EV 充电桩 / 充电基础设施<br>- 新能源汽车 / 电动汽车<br>- V2X/SDV/ADAS/ 自动驾驶 | 网络分析仪         | •            | •                   |
| <b>8月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年6月20日<br>材料提交截止日期: 2025年6月27日    | 存储技术          | •     | •     | •    | •    | - 晶圆代工<br>- 边缘计算 / 内存计算<br>- 数据中心 / 云计算                         | 信号完整性测试       | •            |                     |
| <b>9月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年7月21日<br>材料提交截止日期: 2025年7月28日    | 通信 / 网络技术     | •     | •     | •    | •    | - 卫星通信 / 车载通信 / 量子通信<br>- IT 与 OT 融合 / 人机接口<br>- IIoT/ 工业自动化    | 高速接口          | •            | •                   |
| <b>10月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年8月20日<br>材料提交截止日期: 2025年8月28日   | MEMS/ 传感器     | •     | •     | •    | •    | - 医疗电子 / 低功耗设计<br>- 触控技术 / 语音识别 / 处理<br>- 能量采集 / 可穿戴设备设计        | 嵌入式系统测试       | •            |                     |
| <b>11月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年9月19日<br>材料提交截止日期: 2025年9月26日   | 宽禁带半导体        | •     | •     | •    | •    | - 无线充电 / 能量采集<br>- 电源转换 / 数字电源<br>- 电池管理 / 电源管理 / 散热            | 电源完整性         | •            | •                   |
| <b>12月刊</b><br>广告预订截止日期: 2025年10月20日<br>材料提交截止日期: 2025年10月28日 | 电机驱动与控制       | •     | •     | •    | •    | - 伺服控制<br>- 电路保护<br>- EMI/EMC                                   | 阻抗测试          | •            |                     |

\* 仅限中国大陆版

**编辑查询**

有关中国大陆版的编辑及其他相关事项查询, 请与 Luffy.Liu (Luffy.Liu@aspencore.com) 联系。

注: 发行人保留对以上文章删除及改动的权利。